聯亞光電工業股份有限公司
提升企業價值計畫

為強化公司治理及提升企業價值，本公司依《公司治理實務守則》第13條之3規定，訂定並揭露營運策略與業務計畫。每年更新資金成本、獲利能力、市場評價及公司治理等資訊，協助利害關係人了解公司現況與未來方向。說明如下：

現況分析

一、成本分析

（一）加權平均資金成本(WACC)計算：

截至2025年9月30日，本公司資本結構維持穩健的極低槓桿特性，權益項佔比99.2%，付息債務僅佔0.8%。設算權益成本 (Cost of Equity)為25.8%(註1)，稅後債務成本 (Cost of Debt)為4.5% (註1)。加權平均資金成本 (WACC)約為25.6% (註1)，高於同業平均之17.01%(註2)。

主要原因為本公司多年以來營運現金流量充沛，本業現金收入足以支應現金股利與資本支出，無需透過銀行借款或發行債券籌資，使資本結構高度偏向權益項。基於此特性，本公司的WACC與同業間存在比較基礎上的差異。

（二）總體經濟影響分析：

1. 利率變動：因負債比率極低，升息循環對財務成本影響甚微，本公司尚有充裕的舉債空間 (Debt Capacity)，未來可視產能擴產需求靈活運用低利融資，支應資金需求。
2. 匯率變動：本公司營收主要以美元計價，生產設備（如MOCVD機台）及關鍵原料(如基板)以美元及其他外幣支付，有相當程度的自然避險(Natural Hedge)機制，可部分抵銷匯率波動的影響；此外，公司亦依據避險政策適時進行遠期外匯避險，期能有效控管匯兌損益。
3. 通貨膨脹率：面對通膨可能造成生產成本上升，本公司透過與供應商的長期合作夥伴關係與機動採購策略，能與供應鏈廠商緊密合作，降低價格波動風險。同時持續監測總體經濟指標，確保在通膨環境下，將資金成本與營運費用控制於合理範圍，以維持穩健的獲利結構。

二、獲利能力評估

（一）資本報酬率（ROIC）和股東權益報酬率（ROE）評估：

截至2025年9月30日，本公司投入資本報酬率 (ROIC) 為 5.68%(註3)，股東權益報酬率 (ROE) 為 6.36%。相較同業平均 (ROIC 9.73%、ROE 13.6%)(註3)，目前獲利指標暫低於同業，且ROIC低於資金成本 (WACC 25.6%)。主要原因為本公司先前所辦理的現金增資，每股認購價高於面額，使累積的資本公積偏高（占股東權益43.8%，占總資產37%），影響與同業的報酬率比較基礎。

未來隨著高附加價值之 AI 相關產品出貨持續成長，獲利能力可以進一步提升，持續增進長期股東價值。

（二）業務分析：

全球生成式AI應用推動資料中心算力及光通訊組件需求大幅提升，光模組傳輸速度向800G/1.6T演進。本公司憑藉在矽光子雷射元件的技術優勢，已在全球供應鏈中具有重要地位。未來將持續優化高輸速度產品組合，以技術領先驅動營收與獲利成長。

三、市場評價分析

（一）評價水準分析：

截至 2025 年 9 月底，本公司股價淨值比（PBR）為 10.54 倍，高於同業平均 7.22 倍，主要反映資本市場對本公司在 InP(磷化銦)雷射磊晶技術的高度肯定。作為全球少數具備量產能力的雷射磊晶供應商，本公司具備獨特的市場定位與穩固的技術護城河，構成較高市場估值的核心基礎。

（二）潛在成長評估：

受惠於網路服務及AI應用需求的快速攀升，矽光子（Silicon Photonics）技術商業化進程加速，本公司亦迎來重要的市場擴張契機。展望未來，公司將持續精進良率、強化製程穩定性，並循序擴充產能，以確保符合客戶的訂單需求，並將技術領先優勢和量產經驗轉化為營收及獲利成長，持續提升股東價值。

四、公司治理分析

（一）董事會結構及獨立性：

本公司董事會由七席董事組成，其中包含三席獨立董事，占比43%，獨立董事任期均未超過三屆，能確保決策之客觀性與獨立性。董事成員具備多元且互補的專業背景，涵蓋經營管理、領導決策、半導體等產業經驗、技術研發、財務會計、人力資源管理與公司治理等領域。在性別多元化方面，目前董事會已設有一位女性董事。未來將持續積極延攬具備相關專業及經驗之女性董事候選人，以進一步優化董事會性別比例，落實多元共融的治理精神。

（二）董事會運作之有效性：

公司每年進行董事會及各委員會的內部績效評估，每三年辦理外部評估，內容涵蓋董事參與度、決策品質、組成架構與內控制度等，評估結果於次年第一季提報董事會說明。

（三）資訊透明度：

公司網站設置「公司治理」、「投資人關係」專區；並有發言人及 IR等對外溝通窗口，透過股東會、季度法人說明會及投資論壇交流，加強與資本市場溝通，提升投資人對公司策略與價值的理解。

五、風險及競爭評估

（一）總體經濟分析：

本公司處於全球科技供應鏈之關鍵位置，主要營運據點位於台灣，整體經營環境相對穩定。但如同多數的科技產品供應鏈，因客戶及供應商遍及全球，故日常營運仍會受美中科技競爭與地緣政治變動影響。為降低相關風險，公司採行「市場多元化」與「供應鏈韌性」之雙軌策略。在市場面，公司將持續深化與多家全球大廠之技術合作，強化客戶黏著度與產品規格領先性，並同步拓展歐洲、日本等新興需求市場，以有效分散地域風險。在供應鏈方面，透過分散原料與設備來源、優化庫存與採購策略，以及面對全球匯率波動，透過靈活且紀律化的財務避險工具，降低匯率變化對獲利之衝擊。

（二）產業競爭分析：

本公司在雷射磊晶領域已建立高技術門檻的市場優勢並持續在數據中心、光通訊、消費性產品及LIDAR等應用領域進行前瞻技術研發，強化與國際大廠的策略合作關係。面對光傳輸規格快速演進，我們以技術領先、製程整合和建立量產優勢為策略目標，能快速因應客戶多元技術與規格持續精進的需求。憑藉兼具「技

術深度」與「營運彈性」的雙重優勢，穩固全球供應鏈中的關鍵地位。

政策與計畫

一、短期強化計畫

面對後續AI帶動的強勁需求，公司將快速提高產能以滿足多數客戶在相關應用服務推出的進程，具體措施包括：

1. 提升產能：增加設備及優化生產排程期能提高稼動率與產出。
2. 持續精進良率：精進生產效率及產品良率，降低單位生產成本。
3. 深化客戶合作：與各國客戶共同開發後續產品，確保主要供應商地位，提升長期黏著度。
4. 資本支出監督：董事會密切監督產能擴充計畫之ROI，確保資本支出的報酬成效。

二、中長期強化計畫

公司致力於成為全球領先的「光通訊設計及製造服務平台」，中長期策略如下：

1. 產品組合高值化：
   - 持續擴大矽光子（Silicon Photonics）、CPO等高附加價值產品出貨量。
   - 將核心雷射技術延伸至6G、車用 LiDAR、長波長3D感測及消費性穿戴裝置，打造多引擎驅動的營收成長曲線。
2. 深耕技術與研發：聚焦 InP（磷化銦）與 GaAs（砷化鎵）之次世代材料特性研究，並建立產學合作機制，培育高階光電半導體人才。
3. 智慧製造：導入AI輔助製程控制系統，透過大數據降低人為變異，實現精準製造。
4. 落實ESG 與永續價值：
   - 綠色研發：開發低功耗、高轉換效率的雷射晶片，協助客戶降低能耗，響應全球減碳趨勢。
   - 公司治理：接軌國際ESG揭露準則（如SASB, TCFD），提升資訊透明度，吸引責任投資型法人（SRI），進而提升本公司市值與股東權益。

註1: 資料來源參考 Bloomberg設算

註2: 本報告中之同業係指台灣上市櫃通信網路業公司中市值及資本市場認同度與本公司相近之同業如華星光、上詮、昇達科、全新等。

註3: 資料來源 Bloomberg